



Call for Papers

Deutsche IMAPS Konferenz

Donnerstag 19. / Freitag 20. Oktober 2017, München

Im Herbst jedes Jahres veranstaltet IMAPS Deutschland eine Jahreskonferenz zu aktuellen Themen der Aufbau- und Verbindungstechnik in allen Anwendungsfeldern. Für die Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands möchte IMAPS Deutschland die Jahreskonferenz als eine wichtige Plattform für die dafür erforderliche engmaschige fachliche Diskussion zwischen Industrie und Hochschule sowie Produktion und Forschung verstanden wissen. Wir laden Sie deshalb auch in diesem Jahr wieder herzlich ein, Ihre Ergebnisse zu den nachfolgend genannten mikroelektronischen Packaging-Themen auf unserer Tagung vor Vertretern aus Industrie und Wissenschaft zu präsentieren und gemeinsam zu diskutieren (Vortragsdauer ca. 20 Minuten):

<p>Entwurf, Modellierung, Simulation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisches und elektromagnetisches Design • Thermisches und thermomechanisches Design • Fertigungs- und testgerechtes Design • Aktuelle Schwerpunkte: HF Design und 3D-Entwurf 	<p>Materialien und Prozesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substratmaterialien und Oberflächenschichtsysteme • Herstellung von Verdrahtungsträgern • Verbindungstechnologien (Flip Chip, CoB, SMT, Embedding, ...) • Schutz-, Verguss- und Verkapselungsprozesse und -materialien • Aktueller Schwerpunkt: Nanomaterialien
<p>Technologien der Systemintegration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wafer Level Packaging (CSP, SiP, ...) • Substrate Level Packaging (System on Board, Embedding, ...) • MEMS / Sensor-Packaging • Optoelektronisches Packaging • Aktueller Schwerpunkt: 3D-Packaging 	<p>Qualität und Zuverlässigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prozessüberwachung / Teststrategien • Prüfsysteme • Thermomechanische Zuverlässigkeit • Zuverlässigkeit bei kombinierten Beanspruchungen • Aktueller Schwerpunkt: Lebensdauermonitoring und -vorhersage

Bitte senden Sie Ihren Abstract **bis zum 19. Juli (verlängerte Deadline, ca. 200 Wörter)** zur Bewertung ein. Bitte beachten Sie, dass alle Abstracts über den angegebenen Link in unserem Bewertungssystem registriert werden müssen: <https://www.conftool.net/imaps-herbsttagung-2017/index.php>

Es ist keine Erstellung eines Papers notwendig, lediglich die Präsentationen werden verteilt.
Wir vergeben wieder ein BEST PAPER AWARD!



IMAPS Deutschland, Teil der "International Microelectronics Assembly and Packaging Society" (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit ca. 300 Mitgliedern verfolgen wir drei Ziele: Wir verbinden Wissenschaft und Praxis, wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.